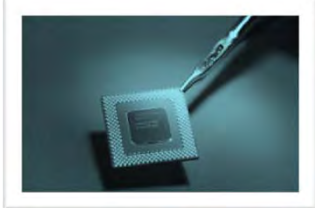
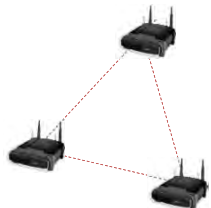


- **データの収集等を可能とするセンサーの小型化・低価格化が進展。**
 - ☞ 3軸加速度センサーについて、チップの大きさは2000年の10mm²から2010年の2～3mm²以下へ小型化、平均販売価格は2000年の約240円以上から2010年の約56円程度へ低価格化が進展。
- **センサーにより収集等したデータを送信する通信モジュールの低価格化が進展、契約者数も増加。**
 - ☞ カーナビや気象観測システム等に搭載される携帯電話の通信モジュールについて、2008年の約2～2.5万円から2010年の約0.6～1万円へ低価格化し、契約数は2008年の約32万件から2010年の約142万件へ増加。

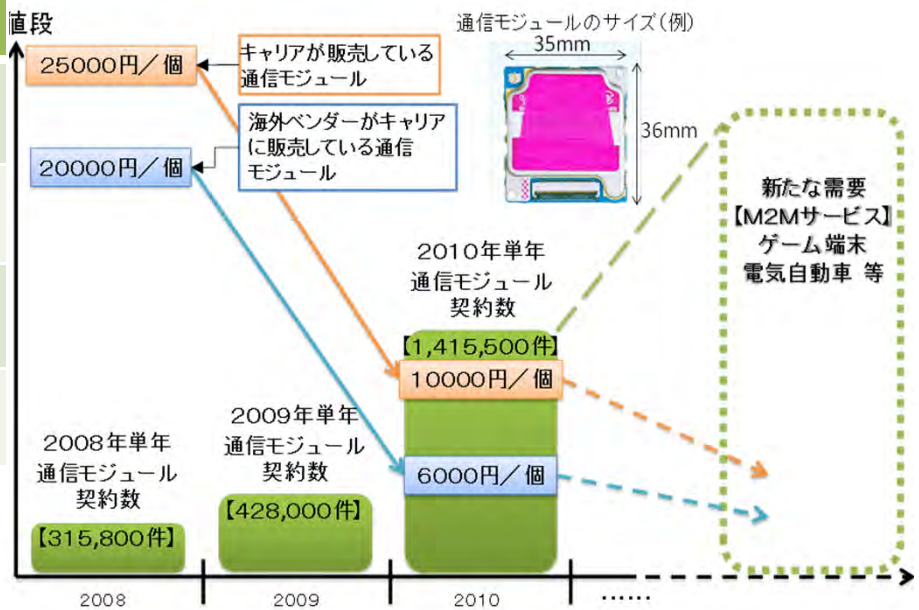
センサの小型化・低価格化

	2000年	2010年	将来 (2020年頃)
チップの大きさ (ダイ表面積)	10mm ²	約2～3mm ²	1～2mm ²
消費電力	0.1mW	0.05mW	0.05mW未満
平均販売価格※	\$3以上 (約240円以上)	\$0.70 (約56円)	\$0.50未満 (約40円未満)
単位生産量	35	771	2500より大



※ 1ドル=80円で換算

携帯電話の通信モジュールの価格推移



【出典】 Jean-Christophe Eloy=Yole Developpement
<http://techon.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20110410/191000/>

【出典】 情報通信審議会答申「携帯電話の電話番号数の拡大に向けた電気通信番号に係る制度等の在り方」(平成24年3月1日)